

(12) **Gebrauchsmusterschrift**

(48) Ausgabetag der Berichtigung: 2008-12-15

(21) Anmeldenummer: GM 313/08 (51) Int. Cl.⁸: H05K 1/18

(22) Anmeldetag: 2008-05-30

(42) Beginn der Schutzdauer: 2008-09-15

(45) Ausgabetag: 2008-11-15

(73) Gebrauchsmusterinhaber:
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE &
SYSTEMTECHNIK
AKTIENGESELLSCHAFT
A-8700 LOBEN-HINTERBERG,
STEIERMARKE (AT).

(72) Erfinder:
KOERTVELYESSY ANDREA
WIEN (AT).
BEESLEY MARK
LOBEN, STEIERMARK (AT).
ZLUC ANDREAS
FUSSACH, VORARLBERG (AT).
SCHRITTWIESER WOLFGANG
KAPFENBERG, STEIERMARK (AT).

(72) Erfinder:
WEICHSELBERGER GÜNTHER
GRAZ, STEIERMARK (AT).
KRIECHBAUM ARNO
LOBEN, STEIERMARK (AT).
MORIANZ MIKE
GRAZ, STEIERMARK (AT).
HASLEBNER NIKOLAI
ZELTWEG, STEIERMARK (AT).
STAHR JOHANNES
BRUCK, STEIERMARK (AT).
HARING FRITZ
BRUCK, STEIERMARK (AT).
FREYDL GERHARD
LOBEN, STEIERMARK (AT).

(54) **VERFAHREN ZUR INTEGRATION WENIGSTENS EINES ELEKTRONISCHEN BAUTEILS
IN EINE LEITERPLATTE SOWIE LEITERPLATTE**

(57) Bei einem Verfahren zur Integration wenigstens eines elektronischen Bauteils in eine Leiterplatte, sind die folgenden Schritte vorgesehen:

- Bereitstellen einer Schicht (4) einer Leiterplatte zur Abstützung des elektronischen Bauteils (1, 2, 3),
- Aufbringen eines Klebers (5) auf eine Oberfläche der Schicht (4),
- Festlegen des elektronischen Bauteils (1, 2, 3) auf der Schicht (4) mittels des Klebers (5),
- Aufbringen bzw. Anordnen wenigstens einer elektrisch leitenden Schicht (8) auf bzw. an dem Bauteil (1, 2, 3) an der vom Kleber (5) abgewandten Seite bzw. Oberfläche, und
- Strukturieren der elektrisch leitenden Schicht (8) entsprechend den Kontakten (7) des elektronischen Bauteils (1, 2, 3) und/oder entsprechend auf der Leiterplatte auszubildenden Leiterbahnen.

Darüber hinaus wird eine entsprechend diesem Verfahren hergestellte Leiterplatte zur Verfügung gestellt.

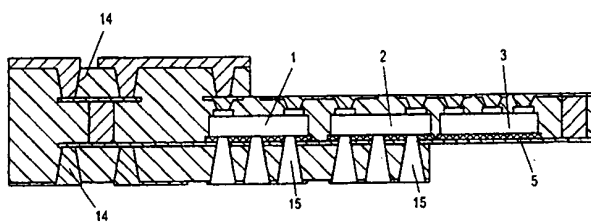


Fig. 5